

イオン研磨装置

前処理重要



【サンプルについて】

搭載可能な試料サイズ

1. 断面ミリング

最大20mm(W)×12mm(D)×7mm(H)
(加工範囲とは異なります)

2. 平面ミリング

最大φ50mm×25(H)mm
最大加工範囲: 直径約5mm

【主な仕様】

- ・使用ガス Ar(アルゴン)ガス
- ・加速電圧 0~6kV
- ・最大ミリングレート(材料Si) 500μm/hr
- ・試料移動範囲
断面加工時 X±7mm、Y0~+3mm
- ・冷却温度調整機能
間接試料冷却、温度設定範囲 0~-100℃

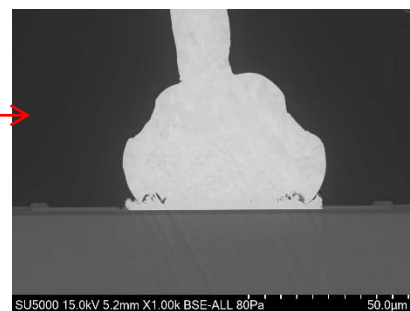
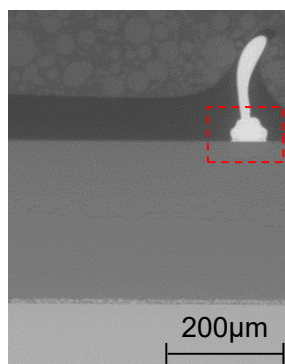
機種名

日立ハイテクノロジーズ
IM4000PLUS
2016年度購入

特徴

- SEMによる内部構造の積層形状、膜厚評価、結晶状態のための試料前処理に。
- 硬度の異なる複合材料でも平滑にイオンミリング可能
- 加工条件(加速電圧、スイング角度)の最適化でダメージ軽減
- 平面ミリングが可能
試料表面層の除去や機械研磨後の最終仕上げに。

ICチップ断面



料金等

機器使用: 1,300円/時
操作法説明: 7,800円(2時間)

別途、消耗品(マスク等)の費用を負担いただきます。

※詳細についてはお問い合わせ下さい。

研究員による支援

3,900円 / 時

試料の前処理指導

サンプル固定方法、事前の断面出し等

加工後の観察も支援いたします

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。